

抗氧鉛錫棒 A.U. Solder Bar

固品之除氧鉛錫棒係以特殊方式處理，將一般鉛錫之氧化物(及即錫渣)除去。當鉛錫熔融時，氧化物之發生量較一般鉛錫減少了將近一半，且鉛錫表面能保持較久時間，對於作業上之改善及產品品質之改良均有良好成效。

Our solder is specially treated to remove oxides. The result is a much lower level (around 50%) of oxides during melting, making the solder easier to handle and reducing waste. Even without the addition of anti-oxidation elements, our solder resists oxidation and will retain a clean surface much longer than common solder. Our solder meets the standard CNS, JIS, and ASTM specifications.

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



特性 Features

- 熔解後氧化物(錫渣)之發生量較一般鉛錫減低近半。
- 錫爐表面光澤如鏡，且液相體較佳，銲接性能更好，減低浪費。
- 本產品已具有防止氧化作用，若錫爐內再微量添加抗氧油脂，則氧化殆無。
- 符合 CNS 正字標記之規定，及 JIS, ASTM 等之規格。

- Oxide occurring after melting approximately 50% less than common solder.
- Solder has highly reflective surface and low viscosity, for improved soldering and reduced waste
- Naturally anti-oxidizing; with the addition of small amounts of anti-oxidizing agents, oxidation can be reduced to almost nil
- Conforms to CNS, JIS, and ASTM standards

抗氧鉛錫棒化學成分之二例 Chemical composition of A.U. bar Solder

成份 composition	Sn	Pb	不純物 Impurities%						
			Sb	Cu	Bi	Zn	Fe	Al	As
Lat 1	59.98	餘量 remainder	0.03	0.003	0.02	0.001	0.002	0.0006	0.008
Lat 2	63.01	餘量 remainder	0.03	0.002	0.02	0.001	0.0015	0.006	0.007



抗氧化 AU 錫棒 (A.U. Solder Bar)

本著 30 年製造技術，固品以其專業技術，將一般焊錫中之氧化物除去，在於自動錫爐使用上有效地減少絕大多數之氧化物，加以優良的共晶組合，對於產品品質能達到一定的成效。

特點：

1. 長時間使用，幾乎無不溶現象存在。
2. 焊錫所適用之材質，為低雜質金屬材料，光澤度及焊接能力達到相當的可靠性。
3. 絕佳的穩定性及合金品質。
4. 符合 A A 級規範。

規格表：

編號	合金成份	Sb	As	Bi	Cd	In	Ag	Cu	Al	Fe	Ni	Zn
KP 63/37	SN63/PB	.005	.005	.002	.0005	.003	.0005	.001	.0002	.003	.0005	.0003
KP 60/40	SN60/PB	.005	.005	.002	.0005	.003	.0005	.001	.0002	.003	.0005	.0003